



SOT223 封装型式

1、封装尺寸：

通常为 6.5mm×3.5mm，引脚间距为 2.3mm，适合表面贴装。



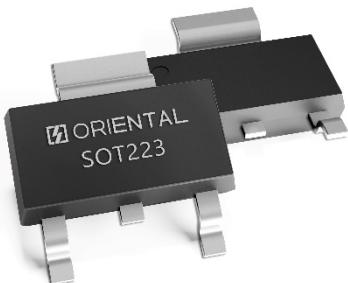
2、引脚数量：

一般有 4 个引脚，其中引脚 4 为散热引脚。



3、散热能力：

通过散热引脚连接到芯片的散热焊盘，可焊接在 PCB 的大面积铜箔上，以增强散热性能，适用于输出电流可达 1A 左右的线性稳压器和功率晶体管。



4、应用领域：

广泛应用于电源管理、运算放大器和射频电路等场景。

